



Ancham[®]

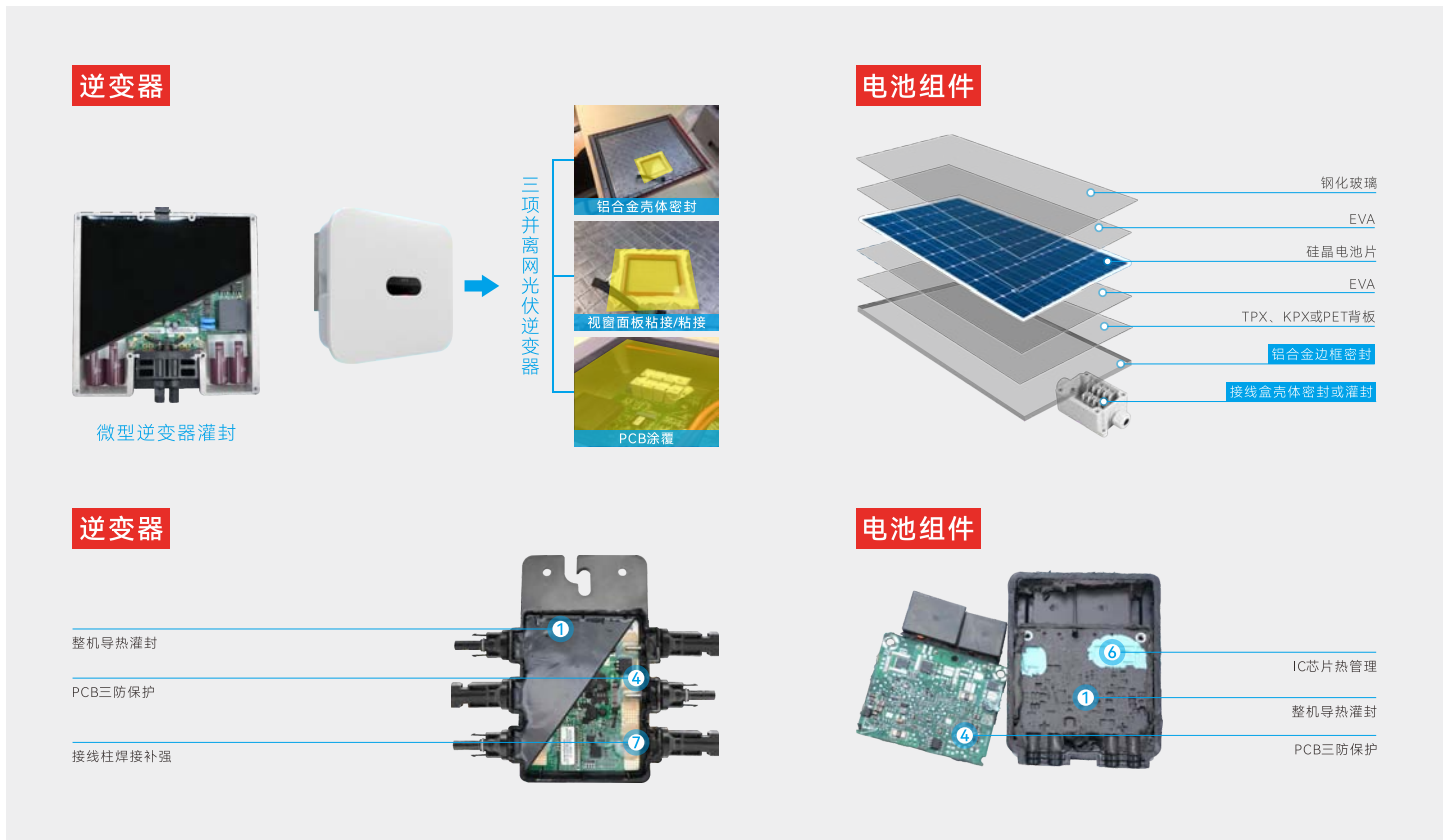
光伏发电系统解决方案

APPLICATION OF ADHESIVE FOR PHOTOVOLTAICS

整机导热灌封 | 壳体密封 | 电池板铝合金边框密封 | PCB三防保护 | 视窗面板粘接 | IC芯片热管理 | 接线柱焊接补强

光伏发电系统解决方案

APPLICATION OF ADHESIVE FOR PHOTOVOLTAICS



1. 整机导热灌封

有机硅导热灌封胶(1:1)

AS42(20)

- 导热率 $2.0\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。
- 100%固态，固化后无渗出物。
- 应力低，更有效的保护电子元器件和芯片。
- 优异的耐环境老化性能和耐高低温性能。
- 符合UL94-V0, RoHS, REACH, 不含卤素。

2. 壳体密封

有机硅粘接密封胶

AS3483

- 韧性优良，抗机械冲击。
- 具有触变性，施胶后不流淌。
- 耐高低温性能优良。
- 适合CIPG工艺应用。
- 无溶剂，低气味，符合RoHS。

3. 电池板铝合金边框密封

有机硅粘接密封胶

AS3445

- 具有触变性，抗垂流。
- 韧性出色，抗冲击。
- 极佳的耐高低温性能。
- 电气绝缘性能优良。
- 无溶剂，符合RoHS。

4. PCB三防保护

有机硅共形覆膜三防漆

AS35(50)

- 100%固含量，无溶剂。
- 低粘度，可厚层涂敷，适合喷涂或流动涂层的应用。
- 出色的电气绝缘性能，耐高低温性能优异。
- 支持UV荧光检测。
- 阻燃性符合UL94-V0。

5. 视窗面板粘接

聚氨酯反应型热熔胶

AP9131

- 固化速度快，粘接强度高。
- 短保压，适合自动化施胶工艺。
- 耐冷热冲击、耐湿、耐化学溶剂性能优异。
- 抗机械冲击，耐环境老化性能优异。
- 符合RoHS, REACH, 不含IBOA, 不含卤素。

6. IC芯片热管理

有机硅导热填缝剂(1:1)

AS42(04)

- 导热率 $4.0\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。
- 100%固态。
- 应力低。
- 耐高低温，介电性能好。
- 阻燃符合UL94-V0，符合RoHS。

7. 接线柱焊接补强

丙烯酸酯胶粘剂

AC5108

- 抗垂流。
- UV快速固化。
- 粘接强度高。
- 抗机械冲击。



扫一扫 了解更多资讯

东莞安川新材料技术有限公司
Dongguan Ancham New Material Technologies Co., Ltd

电话: 0769-83775801 网址: www.ancham.com
传真: 0769-83775803 邮箱: marketing01@ancham.com
地址: 广东省东莞市清溪镇铁河路三街1号
No.1, Third Street, Tiehe Road, Qingxi Town, Dongguan City.